精密
創新
節能
環保



宜得世股份有限公司

｜總公司｜
台灣新北市蘆洲區中正路243巷11、13號
｜電話｜
886-2-2281-9918・2847-1194
｜傳真｜
886-2-2285-6935・2847-1491
｜電子信箱｜
yescan@edex.com.tw
｜網址｜
www.edex.com.tw

｜工廠｜
台灣新北市八里區觀海大道217號
｜電話 ｜
886-2-2610-8396
｜傳真｜
886-2-2610-6396

			EP15-D25	EP15-D35	EP25-D25	EP25-D35
射出單元	射出模式		立式關模/臥式射出			
	柱塞直徑	mm	25	35	25	35
	射出容積	cm^3	50	96	50	96
	射出效率	cm^3/s	19.6	38.5	19.6	38.5
	射出速度	Mm/s	40	40	40	40
	射出壓力	kgf/cm^2	50	50	50	50
	射座行程	mm	120	120	120	120
	射座推力	Tonf	0.195	0.195	0.195	0.195
	噴嘴高度	mm	65~150			
開關模單元	開關模形式		固定模 單滑板	固定模 單滑板	雙滑板	雙滑板
	最大鎖模力	KN/Tonf	15 / 1.5	15 / 1.5	25 / 2.5	25 / 2.5
	支柱內距	mm	360	360	-	-
	最大模具尺寸	mm	-	-	450 X 210	450 X 210
	最大模板距離	mm	350	350	350	350
	模具最小空間	mm	105	105	105	105
	模板尺寸	mm	450 X 200	450 X 200	450 X 210	450 X 210
	托模力/行程	Tonf/mm	0.2 / 50			
	電熱段數	set	N1+N2+H1+T1			
	電熱容量	KW	4			
機械形式	機械尺寸	m(LxWxH)	1.3 x 0.55 x 1.84		1.45 x 1.57 x 1.93	
	機械重量	Ton	0.55		1.0	

Edex

宜得世 低壓熱熔膠射出機



封裝射出和開關模伺服馬達動力 射座和托模氣壓動力
伺服馬達精準控制射出能量 可以極低壓封裝任何形狀的產品

CE

Web Line

宜得世 低壓熱熔膠射出機

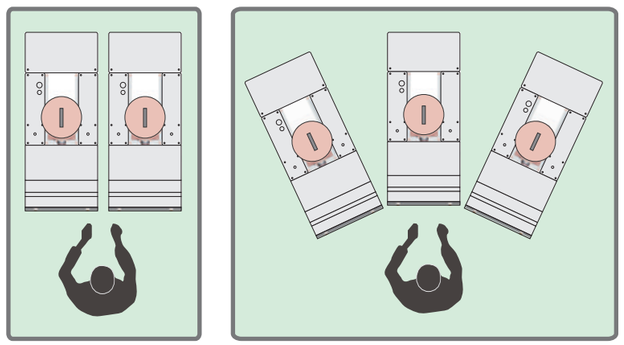
宜得世低壓熱熔膠射出機的技術優勢

宜得世熱熔膠封裝射出機，是世界第一部以專利柱塞射出方式進行熱熔膠封裝的射出機，不同於以往利用液態泵浦擠壓進模具的押出封裝方式，配合精準的伺服馬達以及電腦演算，可將射出能量依產品封裝需要作任意動力組合，配合伺服動力的精準鎖模控制，讓熱熔膠的封裝更精準、更容易，最精銳的技術和最專業的服務，是您最具競爭力的合作夥伴。

	宜得世低壓機	傳統低壓機
封裝工法	射出	押出
封裝動力型式	伺服馬達	齒輪泵浦
封裝動力調整	射出 壓力速度3段 / 保壓 壓力速度2段	扭力1段
開關模動力模式	伺服馬達	氣壓
電熱段數	料管1段 / 噴嘴1段 / 料桶2段	料管1段 / 料桶1段

宜得世低壓熱熔膠射出機的多元應用

宜得世以功能齊全的標準機來滿足最廣泛的應用需求，減少客戶購置機種的浪費，最窄的機身可以節省空間，也可以將兩台或三台機並排，即可滿足一人操作多機的需求，不必另購多工的機種。在客戶特殊需求的量身訂做方面，宜得世具有絕佳的研發能力，能滿足客戶長期使用的多元應用需求，絕對是您長期合作的最佳夥伴。



■ 最窄的機身設計，可多機一人操作



宜得世低壓熱熔膠射出工法

絕 緣　防 水　防 塵　防 震　防汙染　耐候性

宜得世熱熔膠封裝射出工法，是將固態熱熔膠粒以電熱熔化成液態後，再以電腦控制的動力利用柱塞射出的方式，將熱熔膠經澆道射進埋入電子零件的產品，待冷卻後即成為平整的封裝狀態，是一種具備精準低壓控制、快速冷卻成型、不破壞敏感電子零件的高效率封裝方法，有效降低生產成本，並能使產品確實達到絕緣、防水、防塵、防震、防污染、耐候性等目標。

熱熔膠簡介

熱熔膠(HMA)是無揮發性的黏著性塑料，常溫為固態，熔融後成為穩定不易碳化的膠狀液體，固化後收縮率極低可完全黏著於大多數材質的產品，可以廣泛使用於汽車、電子、醫療業之感測器和防水件之封裝，也可使用在PC板的部分防護封裝，比傳統環氧樹脂手工點膠方式更快速、不佔地方、精密、防震，已成為封裝的新塑材。

宜得世低壓熱熔膠射出機的特色

置入產品於模具中 → 關模射出 → 冷卻開模 → 托模 → 取出產品

- 1~50bar的超低壓射出壓力，絕不破壞電子零件
- 1~15kn超低鎖模壓力，絕不傷害產品
- 150~220度低溫熱熔膠，不會破壞晶片性能
- 封裝採伺服馬達動力射出方式，配合日本電腦輸出動力穩定確保封裝品質
- 開關模伺服馬達動力，行進穩定精確控制排氣
- 10~60秒快速生產週期，降低封裝成本
- 取出產品即可包裝，不會佔據廣大排列空間

- 立式伺服馬達直驅鎖模方式
- 水平分模線射出工法
- 12”鍵盤或15”全彩觸控式螢幕控制器
- 三段射出及二段保壓精密控制
- 伺服馬達動力射出工法，最精準封裝品質
- 安全光柵與雙啟動開關，安全防護最完善